

第66期 事業報告書
平成16年4月1日▶▶▶平成17年3月31日
DISCO CORPORATION

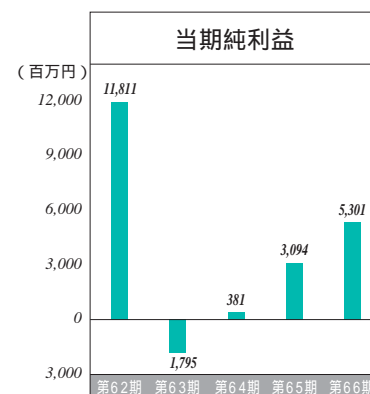
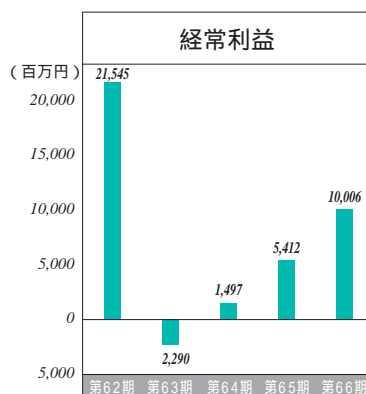
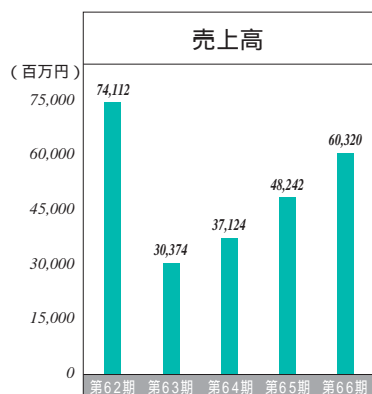


DISCO

主要財務数値(連結)

(単位：百万円)

	平成13年3月期 (第62期)	平成14年3月期 (第63期)	平成15年3月期 (第64期)	平成16年3月期 (第65期)	平成17年3月期 (第66期)
売上高	74,112	30,374	37,124	48,242	60,320
経常利益	21,545	2,290	1,497	5,412	10,006
当期純利益	11,811	1,795	381	3,094	5,301
1株当たり当期純利益(円)	367.76	55.91	11.80	94.72	162.57
株主資本	51,601	49,203	48,746	51,002	55,726
総資産	86,435	63,720	61,908	80,353	84,839
株主資本当期純利益率(ROE、%)	25.6	3.6	0.8	6.2	9.9



目次

主要財務数値(連結)	1
株主の皆さまへ	2
DISCO TODAY	4
部門別営業概況	7
業績のポイント(連結)	9
財務諸表(連結)	11
財務諸表(単独)	12
会社概要/役員	13
株式概要	14

株主の皆さまへ



代表取締役会長
関家 憲一

代表取締役社長
溝呂木 斉

良好な市場環境を受け 過去2番目の好業績を実現

2005年3月期の半導体市場は世界的な景気回復、アテネ五輪の開催など好要因に支えられて堅調な伸びを示し、半導体生産量は過去最高となりました。半導体用途別では薄型テレビ・DVDレコーダ・デジタルカメラという、いわゆる“新三種の神器”の本格的普及が市場牽引役となりました。

しかしながら、2004年度通期では半導体メーカーが2001年のITバブル崩壊時の反省から早期に在庫調整を実施したため、半導体市場は上期にピークを迎え、下期

に急速に調整期に入りました。こうした動きを受け半導体メーカーの設備投資も抑えられたため、製造装置市場もその影響を受けました。

当社はこのような市場環境の中、前期に引き続き顧客満足向上活動や積極的な販売拡大に取り組み、過去2番目の好業績を実現いたしました。好業績の要因としては、第1に装置、精密加工ツール(精密ダイヤモンド砥石)ともに売上が好調であったことが挙げられます。特に精密加工ツールは、過去最高の半導体生産量に連動して過去最高の売上を記録しました。第2に装置売上に占める新機種比率が65%となり、売上のモデルミックスが好転したことが挙げられます。お客様のCoQ(Cost of Ownership)の低減やスループット(生産性)の向上を実現し、設計レベルでの原価低減にも成功した新機種の販売を強化してきたことが、利益率を好転させました。

以上の結果、当期の連結売上高は603億20百万円(前年同期比25%増)、連結営業利益は98億69百万円(同75.4%増)、連結経常利益は100億6百万円(同84.9%増)、連結当期純利益は53億1百万円(同71.3%増)、1株当たり当期純利益は162.57円(同71.6%増)となりました。配当につきましては、「新R&Dセンター機能」の完成を記念し、普通配当30円の他に、10円の記念配当を行い、年間40円(うち期末は25円)とさせていただきます。

4年累計で売上高経常利益率20%以上の態勢を目指す

当社では、2010年時点での自分たちの「あるべき姿」をビジョンとして提示し、これを実現するための施策に全社一丸となって取り組んでいます。ビジョンでは経営数値目標の1つとして「4年累計で20%以上の売上高経常

利益率を維持する態勢の構築」を掲げています。

4年累計で数値目標を設定しているのは、市場変動が著しい半導体業界で事業を展開しているためです。当社の収益はシリコンサイクルの影響を受けやすく、短期的な収益目標を追うことは合理的ではありません。継続的にビジネスモデルの強化を図り、コスト面での徹底的な効率化を推進しながら、目標の達成を目指します。

この目標を達成するため、現在、次のような施策を推進しております。

1つ目は、精密加工ツールビジネスの拡大です。本ビジネスは装置と異なり、変動の激しい半導体設備投資に依存しないため、収益の安定性が確保できます。そのため当社は、2010年には固定費を賄えるレベルまでこのビジネスを育成する目標を掲げています。

2つ目は、全社全部門におけるあらゆる業務の見直しを通じた構造的経費削減の推進です。この成果を最大化するために、中間管理職層のマネジメント能力向上を図るための活動を全社に展開しています。

3つ目は、継続的な施策として進めている生産改革です。市場変動が著しい事業環境においては、急激な需要下落リスクが避けられません。そのため2002年度から、必要な分だけ仕掛かる「プル生産方式」を導入しました。さらに、固定的な費用となりやすい労務費を変動費化するため、特に繁忙期に外部製造要員(アウトソース)の活用を積極的に行っています。

市場の伸びは弱いものの 底堅い業績を見込む

来期の見通しといたしましては、不透明な要素が多いものの、半導体・製造装置市場ともに大きな底割れはないものと予想しております。最終製品の需要も比較的安

定的に推移していることから、今回の谷は比較的短期間で回復に向かうと見込んでおります。

今後の市場機会として、薄化・難加工ニーズの拡大が挙げられます。スタックド・パッケージのような薄化ニーズにこたえるグラインダ・ポリッシャや、Low-k膜グルーピングのような難加工ニーズにこたえるレーザーソーが、活発な受注を見込まれています。

もうひとつの市場機会としては、半導体製造において本格化してきた300mm化のトレンドがあります。現在、半導体メーカーやサブコン(半導体受託製造会社)が発表している大型の設備投資計画は、ほとんどが300mmラインの予定です。300mm化の進展に伴い、当期は30%程度だった当社の300mm装置の売上高比率も、来期は40%台まで拡大すると期待しています。

市場は大きな伸びを見込めませんが、来期も戦略分野における研究開発・営業活動を積極的に行い、またお客様からのニーズを満たす「Kiru・Kezuru・Migaku」のソリューションに磨きをかけ、目標達成に邁進してまいります。

株主の皆様におかれましては、より一層の御支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成17年6月

代表取締役社長

DISCO TODAY お客様のパートナーとして選ばれるために

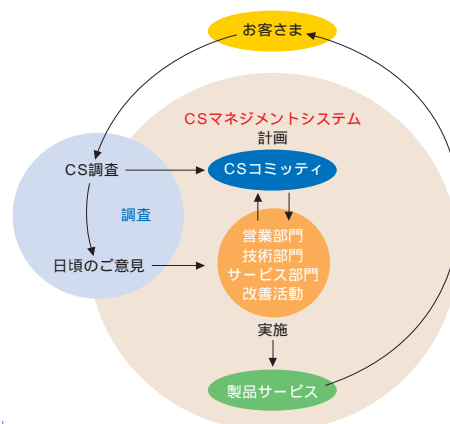
当社は「Kiru・Kezuru・Migaku」ならディスコとお客
様から信頼される企業を目指しています。そのため「お
客様満足 (Customer Satisfaction、以下CS)の向上」
を最重要方針として掲げ、組織的なCS活動を強力に推進
しています。

1. お客様満足向上へ向けた仕組み

営業・開発・サービスに携わる従業員全員がお客様の
声に耳を傾け、何を求めているかを把握し、ニーズに
マッチした最適なソリューションを提供する。これが当
社のCSに対する基本的な考え方です。この考え方に基づ
き、当社では、CS向上活動の要となる「CSサイクル」を
組み込んだ「CSマネジメントシステム」を構築し、施策の
展開を図っています。

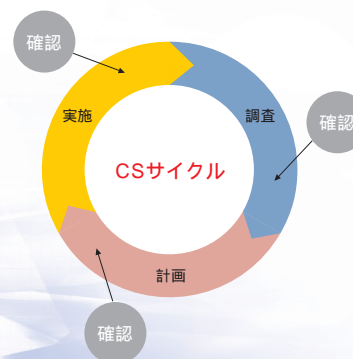
「CSマネジメントシステム」は、経営層と直結した「CS
コミッティ(委員会組織)」と、専任部門によって運営され
ています。CSコミッティが策定した1年間の目標・施策
を、各部門が計画に沿って実行しています。各部門で実
施された活動は、その実態を調査・分析し、CSコミッ
ティに報告されています。

また、CSは自己評価が難しいため、客観データを元に
活動のレベルを認識する必要があります。当社では、毎年
「お客様満足度調査」を実施して、お客様の評価を聞き、
改善活動に向けた課題を抽出しています。



「CSコミッティ」

担当役員と関連部門から構成されています。
なお「CSマネジメントシステム」は、国際標準化機構規格
「ISO9001:2000」の認証を取得しています。



「CSサイクル」

CSサイクルは、お客様の声を企業活動に反映させるための
基本的な仕組みです。
「調査」「計画」「実施」というCS向上に取り組む活動のサイク
ルと、それぞれの活動での「確認」という一連の流れを、途
切れることなく進めていきます。



本社・R&Dセンター

2004年11月、東京都大田区大森に本社・R&Dセンターの新社屋が完成しました。これまで分散していた東京地区の全機能が一カ所に集約されました。当社のビジネスモデルの強化が図られ、今後の顧客価値創造に大いに役立つインフラとなります。

アプリケーションラボ

40以上のデモルームを備え、専任の技術者が常駐して、アプリケーション技術の開発・提案を行う当社のCS最前線です。精密加工ツール・装置・アプリケーション技術が三位一体となり、お客様に満足いただける「高度なKiru・Kezuru・Migaku」ソリューションを提供しています。

2. お客様満足向上を目指した インフラの充実

R&Dセンター

新本社・R&Dセンターは、顧客価値創造のための戦略的拠点です。建物の約70%が研究開発用のスペースとなっており、アプリケーション開発機能、さらには精密加工ツール・装置の新製品の試作工場機能も一体化しています。都心という利便性の中で、世界中からいらっしゃるお客様を迎え、開発部隊がお客様の声を身近に聞きながら「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」を提供するというビジネスモデルが一層強化されました。また、これまで分散していた「開発」「営業」「サービス」すなわち当社とお客様との間に架かる3本の橋を1カ所に集約したことで、部門間の連携が強化されました。

アプリケーションラボ

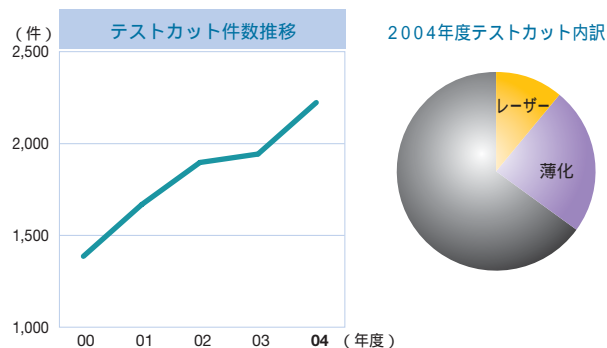
当社では「お客様が求めているのは製品そのものではなく、その製品を使って得られる加工結果である」と考えています。アプリケーションラボでは、専任の技術者が精密加工ツールの選定・開発、装置の条件設定、加工不良の防止策などをテストカットを通じて開発します。

なおお客様には、このテストカットを無料でご利用いただいています。



テストカット件数は年々増加し、当期は2,000件を超えました。テストカットを通じて、お客様が必要としている先端技術ニーズや技術トレンドを把握することが可能です。また、お客様とのやり取りを通して生まれるアプリケーション技術の蓄積は、当社にとって大きな競争力の源泉となっています。これからも当社は、アプリケーションラボから生まれるノウハウや技術ニーズを新製品や新技術の開発に活かし、「高度なKiru・Kezuru・Migaku」ソリューションを提供していきます。

最新アプリケーション開発の動向



時代の最先端を行く技術開発 先端技術ニーズ

薄化技術

薄化技術が必要とされるスタックド・パッケージ市場は、半導体の高機能化・高性能化に伴い、引き続き拡大が予想されます。現在量産されている最先端品はチップ厚75 μ mですが、チップの多層化がさらに進めば高度な薄化技術が不可欠です。加えて、極薄チップの強度を高めるストレスリリーフ技術も求められています。

レーザー技術

レーザーアプリケーションの裾野もここ1年で急速に広がっています。当社開発のLow-k膜のグルーピング加工は、評価段階から量産段階に移行しており、今後、追加受注を期待しています。また多様な加工方法・対象素材でのレーザー技術開発が進行中で、レーザーのテストカット件数も2004年度には150件を超えています。

「高度なKiru・Kezuru・Migaku」分野

当社のコア技術。「Kiru・Kezuru・Migaku」は人々の生活にとって、決して無くなることのない加工技術です。当社は、長年にわたりこの分野に集中して研究開発を行い、時代の先端を行く、誰にもまねできないレベルの「Kiru・Kezuru・Migaku」ノウハウに磨きをかけています。

部門別営業概況

電子業界関連製品事業

電子業界関連製品事業では、ダイシングソー、グラインダなどの装置、精密ダイヤモンド砥石などの精密加工ツール、精密電子部品の製造・販売およびアフターサービスを行っています。販売先は半導体メーカーや電子部品メーカーなどが占めており、当社の連結売上高の95%を占める中核セグメントです。

主要製品である装置の売上は、顧客企業の設備投資動向の影響を受けやすいため変動が大きく、精密加工ツールの売上は、半導体生産量に依存するため比較的安定性があるという特徴があります。

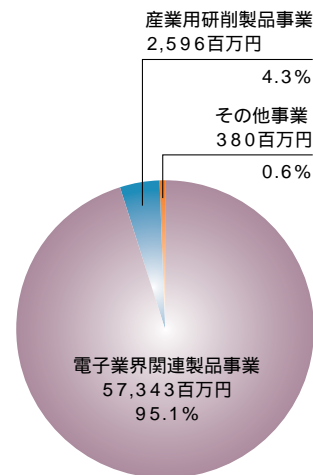
当期は、世界経済回復やアテネ五輪開催などを背景に、薄型テレビ、DVDレコーダ、デジタルカメラといったデジタル家電の需要が拡大したため、半導体・電子部品メーカーは高い設備稼働率を維持しました。景気がピークを迎えた夏季以降、在庫調整局面に入りましたが、年間を通じてみると半導体の主な用途であるPCや携帯電話の堅調な需要に支えられて、出荷数量、金額ともに前年を上回って推移しました。

当社製品はこの動きを受けて、装置の売上高が前年を上回りました。特に、IC切断用ダイシングソー、携帯電話、デジタルカメラなどに搭載されるCCD、CMOSセンサ、チップサイズパッケージ(CSP)切断用ダイシングソー、半導体向けグラインダなどが伸びました。

一方、精密加工ツールは、世界半導体生産量が過去最高であったことに伴い、売上高の記録を更新しました。

地域別では、すべての地域で売上高が前年を上回りました。特にアジア

第66期 部門別売上構成



ダイシングソー



ダイシングブレード



グラインダ



グラインディングホイール



産業用ダイヤモンド砥石

ア地域においては、サブコン(半導体製造受託会社)の高稼働率、設備投資増加に伴い、装置、精密加工ツールの売上が伸びました。

以上の結果、当期における部門売上高は573億43百万円(前年同期比26.3%増)、営業利益は131億84百万円(同50.1%増)となりました。粗利率は、主に装置のモデルミックスの好転により、4期ぶりに50%台となりました。

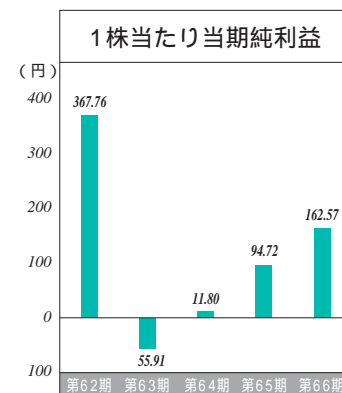
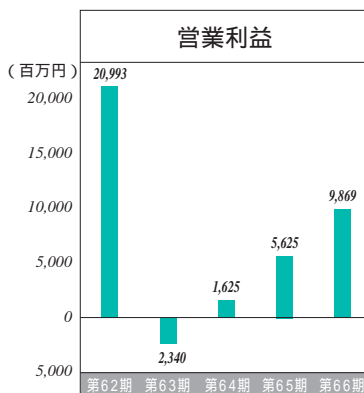
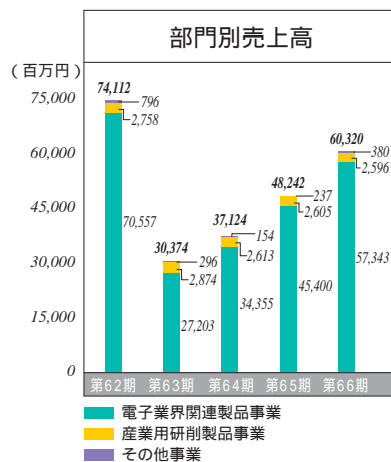
産業用研削製品事業・その他事業

産業用研削製品事業は、道路やアスファルトなどを研削する産業用ダイヤモンド工具の製造・販売を行っています。

当期は積極的な販売活動を展開しましたが、国や地方公共団体による公共事業抑制策などの影響を受け、売上高は25億96百万円(同0.3%減)となりました。しかし、コスト削減などの合理化に努めた結果、営業利益は2億21百万円(同17.8%増)と増益となりました。引き続き海外を中心に広く販路を開拓するとともに、海外製造比率を高めてコスト競争力を強化していく予定です。

その他事業は、半導体製造装置メーカーや半導体メーカー向けのコンピュータソフトの設計・販売などを行っています。当初は、自社のダイシングソーに使用するソフト開発のために設立されましたが、現在では半分以上が当社以外からの売上となっています。当期の売上高は3億80百万円(同60.2%増)と増加しましたが、営業利益は26百万円(同35.6%減)と減益となりました。

業績のポイント(連結)



部門別売上高

半導体市況の回復を反映し、装置を中心に受注が増加しました。また精密加工ツールも前期に引き続き増加し、過去最高となりました。この結果、電子業界関連製品事業の売上高は573億43百万円(前期比26.3%増)となり、全体の売上高は603億20百万円(前期比25.0%増)となりました。

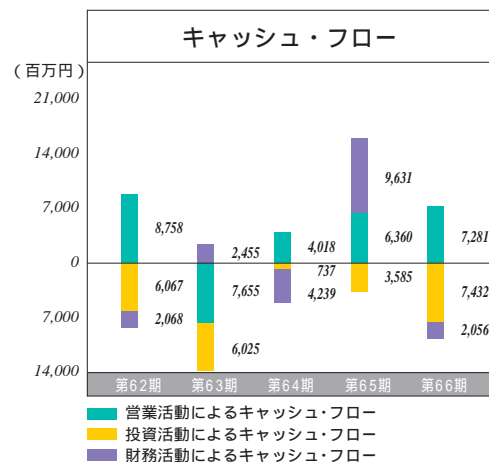
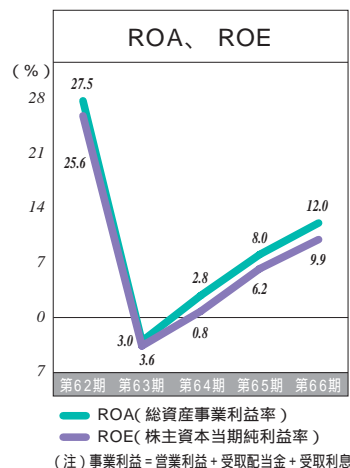
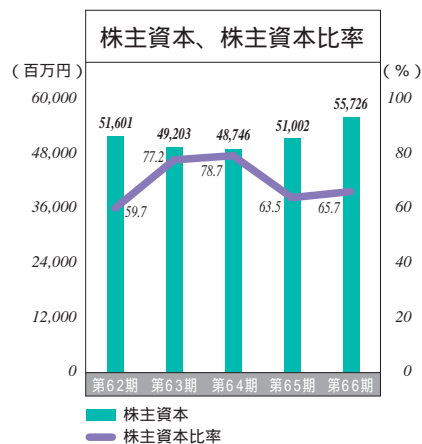
営業利益

売上高の増加に加え、機械のモデルチェンジ進展により採算の良好な新機種がさらに上昇して粗利益率が改善されたことなどによって、電子業界関連製品を中心に営業利益は増益となりました。

1株当たり当期純利益

当社は第62期において、1:1.5の株式分割を実施しています。

当期は当期純利益の増益(前期比71.3%)により、1株当たり当期純利益が前期の94.72円から162.57円へと大幅に増加しました。



株主資本、株主資本比率

株主資本は、当期純利益が53億1百万円となったことなどから前期末比47億24百万円増加しました。総資産に占める株主資本の比率（株主資本比率）は、本社・R&Dセンターの土地・建物取得などにより分母である総資産が前期末比44億85百万円増加しましたが、利益面の改善がこれを上回ったため、前期末比2.2ポイント増加して65.7%となりました。

ROA、ROE

ROA（総資産から得られる収益率）は、本社・R&Dセンターの土地・建物取得により分母である総資産が増加しましたが、利益面の改善がこれを上回り、前期比4.0ポイント向上して12.0%となりました。ROE（株主資本から得られる収益率）も同様に、利益面の改善などによって前期比3.7ポイント増加して9.9%となりました。

キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは72億81百万円の収入と前期比9億20百万円増加しましたが、昨年11月に竣工した本社・R&Dセンターの土地・建物取得により投資活動によるキャッシュ・フローが前期比38億46百万円増加して74億32百万円の支出となったため、双方を合算したフリーキャッシュ・フローは1億51百万円のマイナスとなり前期比29億26百万円減少しました。また、主に長期借入金返済と社債償還により、財務活動によるキャッシュ・フローは20億56百万円の支出（前期は96億31百万円の資金獲得）となりました。

財務諸表(連結)

連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	第65期 (平成16年3月31日現在)	第66期 (平成17年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	19,031	16,891
受取手形及び売掛金	16,903	16,421
棚卸資産	13,692	15,005
その他	1,971	2,198
流動資産合計	51,598	50,517
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	8,462	11,705
機械装置及び運搬具	3,641	4,096
土地	5,710	12,507
その他	3,975	1,096
有形固定資産合計	21,788	29,406
無形固定資産		
投資その他の資産	774	412
投資有価証券	2,001	1,724
その他	4,189	2,778
投資その他の資産合計	6,191	4,502
固定資産合計	28,754	34,321
資産合計	80,353	84,839
(負債の部)		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,652	5,159
短期借入金	1,479	1,064
未払法人税等	2,098	2,790
その他	5,784	5,952
流動負債合計	15,015	14,966
固定負債		
新株予約権付社債	9,000	9,000
長期借入金	2,520	1,980
長期未払金	—	1,042
退職給付引当金	1,723	1,736
その他	913	84
固定負債合計	14,156	13,843
負債合計	29,171	28,809
(少数株主持分)		
少数株主持分	179	302
(資本の部)		
資本金	9,795	9,885
資本剰余金	10,664	10,967
利益剰余金	30,970	35,024
その他有価証券評価差額金	138	137
為替換算調整勘定	547	259
自己株式	18	29
資本合計	51,002	55,726
負債、少数株主持分及び資本合計	80,353	84,839

連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	第65期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	第66期 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
売上高	48,242	60,320
売上原価	25,224	29,740
販売費及び一般管理費	17,392	20,710
営業利益	5,625	9,869
営業外収益	432	457
営業外費用	644	319
経常利益	5,412	10,006
特別利益	58	377
特別損失	184	1,303
税金等調整前当期純利益	5,286	9,080
法人税、住民税及び事業税	2,293	3,476
法人税等調整額	156	188
少数株主利益	54	114
当期純利益	3,094	5,301

連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(単位:百万円)

科目	第65期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	第66期 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,360	7,281
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,585	7,432
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,631	2,056
現金及び現金同等物に係る換算差額	282	68
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	12,123	2,139
現金及び現金同等物の期首残高	6,666	19,031
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	240	—
現金及び現金同等物の期末残高	19,031	16,891

連結剰余金計算書

(単位:百万円)

科目	第65期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	第66期 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	10,638	10,664
資本剰余金増加高	25	303
新株引受権の権利行使による増加高	25	98
連結子会社合併に伴う増加高	—	205
資本剰余金期末残高	10,664	10,967
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	28,529	30,970
利益剰余金増加高	3,252	5,301
当期純利益	3,094	5,301
新規連結に伴う増加高	157	—
その他の増加高	0	—
利益剰余金減少高	811	1,246
配当金	803	964
役員賞与	3	61
自己株式処分差損	—	0
連結子会社合併に伴う減少高	—	205
その他の減少高	5	16
利益剰余金期末残高	30,970	35,024

財務諸表(単独)

貸借対照表

(単位 : 百万円)

科 目	第 6 5 期 (平成16年3月31日現在)	第 6 6 期 (平成17年3月31日現在)
(資 産 の 部)		
流動資産		
現金及び預金	16,406	14,177
受取手形	572	1,342
売掛金	13,086	10,832
棚卸資産	11,607	13,301
その他	3,492	3,620
流動資産合計	45,165	43,274
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	7,031	10,373
機械及び装置	3,308	3,717
土地	4,983	11,956
その他	3,936	1,101
有形固定資産合計	19,259	27,149
無形固定資産		
投資その他の資産	521	173
投資有価証券	1,164	1,073
関係会社株式	4,443	3,760
その他	3,806	2,800
投資その他の資産合計	9,414	7,634
固定資産合計	29,195	34,956
資産合計	74,361	78,231
(負 債 の 部)		
流動負債		
支払手形	2,205	1,952
買掛金	2,714	2,161
短期借入金	840	440
未払金	2,689	2,583
未払法人税等	1,717	2,349
その他	2,178	2,645
流動負債合計	12,345	12,133
固定負債		
新株予約権付社債	9,000	9,000
長期借入金	1,720	1,280
長期未払金	—	1,040
退職給付引当金	1,493	1,642
役員退職慰労引当金	851	—
固定負債合計	13,064	12,963
負債合計	25,410	25,096
(資 本 の 部)		
資本金	9,795	9,885
資本剰余金	10,664	10,967
資本準備金	10,664	10,967
利益剰余金	28,371	32,173
利益準備金	594	594
任意積立金	17,028	17,024
当期末処分利益	10,748	14,554
その他の有価証券評価差額金	138	137
自己株式	18	29
資本合計	48,950	53,134
負債及び資本合計	74,361	78,231

損益計算書

(単位 : 百万円)

科 目	第 6 5 期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	第 6 6 期 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
売上高	36,439	46,480
売上原価	19,153	23,098
販売費及び一般管理費	14,056	16,949
営業利益	3,230	6,432
営業外収益	1,255	1,842
営業外費用	461	191
経常利益	4,023	8,083
特別利益	0	44
特別損失	172	1,201
税引前当期純利益	3,852	6,926
法人税、住民税及び事業税	1,754	2,679
法人税等調整額	159	563
当期純利益	2,256	4,811
前期繰越利益	8,974	10,225
自己株式処分差損	—	0
中間配当額	481	482
当期末処分利益	10,748	14,554

利益処分

(単位 : 百万円)

科 目	第 6 5 期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	第 6 6 期 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
当期末処分利益	10,748	14,554
任意積立金取崩額	3	3
買換資産圧縮積立金取崩額	3	3
国庫補助金等圧縮積立金取崩額	0	0
合計	10,752	14,558
利益処分額	526	869
配当金	481	804
役員賞与金	45	65
次期繰越利益	10,225	13,688

(注) 買換資産圧縮積立金および国庫補助金等圧縮積立金は、租税特別措置法および法人税法の規定に基づくものであります。

会社概要

社名	株式会社ディスコ DISCO CORPORATION
本店所在地	東京都大田区大森北二丁目13番11号
創業年月日	1937年5月5日
設立年月日	1940年3月2日
資本金 (2005年3月31日現在)	9,885百万円
従業員 (2005年3月31日現在)	1,246名
主な事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・精密研削切断装置の製造および販売 ・精密研削切断装置のメンテナンスサービス ・精密研削切断装置の保守部品の販売 ・精密研削切断装置のオペレーションやメンテナンスの研修サービス ・精密研削切断装置の解体リサイクル事業 ・精密ダイヤモンド砥石の製造および販売 ・精密部品の有償加工サービス
事業所	本社・R&Dセンター 広島事業所(呉工場、桑畑工場、長谷工場)
国内拠点	大阪支店、九州支店、仙台営業所、名古屋営業所、諏訪営業所

	ディスコグループ関連会社
国内法人	株式会社テクニスコ 株式会社ディスコ アプライシブ システムズ 株式会社ディーエスディー 株式会社ディーエスディー九州 株式会社ダステック
海外法人	DISCO HI-TEC AMERICA, INC. DISCO HI-TEC EUROPE GmbH DISCO HI-TEC FRANCE SARL DISCO HI-TEC U.K. LTD. DISCO HI-TEC MOROCCO SARL DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD DISCO HI-TEC (MALAYSIA) SDN. BHD. DISCO HI-TEC (THAILAND) CO., LTD. DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. DD Diamond Corporation S.E.A. Utensili Diamantati S.p.A. DISCO-SEA AMERICA, INC.

役員 (平成17年6月24日現在)

代表取締役会長	関家 憲一
代表取締役社長	溝呂木 斉
常務取締役	関家 圭三
常務取締役	関家 一馬

取締役	関家 英之
取締役	梶山 啓一
取締役	溝呂木 隆夫
取締役	田村 隆夫

常勤監査役	玉利 晋
常勤監査役	古川 深志
監査役	浅海 芳久
監査役	木谷 孟

株式概要 (平成17年3月31日現在)

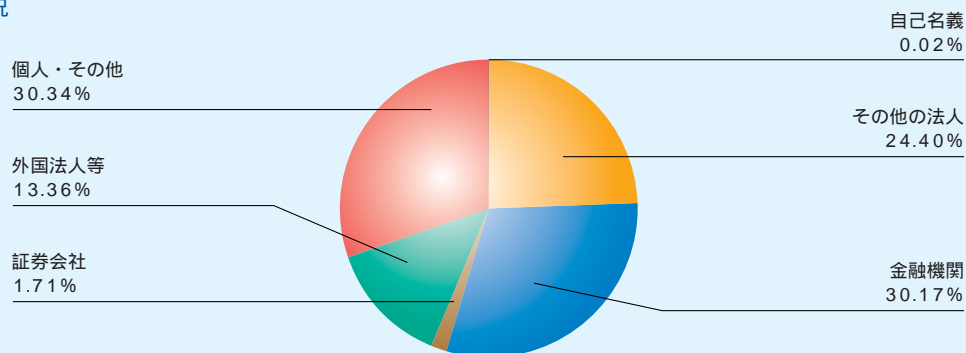
上場証券取引所 東京証券取引所 市場第一部(証券コード6146)

発行済株式総数 32,180,240株

株主数 15,910名

大株主	株主名	株数	割合	大株主	株数	割合
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	3,194千株	9.93%	関家 臣二	1,433千株	4.45%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	2,352千株	7.31%	関家 憲一	1,041千株	3.24%
	株式会社ダイイチ企業	1,998千株	6.21%	株式会社オレンジコーラル	846千株	2.63%
	株式会社ダイイチホールディングス	1,998千株	6.21%	日本生命保険相互会社	809千株	2.51%
	株式会社OCTAGON LAB	1,709千株	5.31%	資産管理サービス信託銀行株式会社	797千株	2.48%

所有者別株式数分布状況



株価チャート



株 主 メ モ

決 算 期	毎年3月31日
定 時 株 主 総 会	毎年6月
利益配当金受領株主確定日	毎年3月31日
中間配当金受領株主確定日	毎年9月30日
基 準 日	定時株主総会については、毎年3月31日といたします。 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
名 義 書 換 代 理 人	東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 UFJ信託銀行株式会社
同 事 務 取 扱 所	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-711(フリーダイヤル)
同 取 次 所	UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
公 告 掲 載 新 聞	日本経済新聞

本報告書に関するお問い合わせ
株式会社ディスコ IR・渉外室 TEL (03) 4590-1099 / FAX (03) 4590-1094

ホームページ

<http://www.disco.co.jp/>

